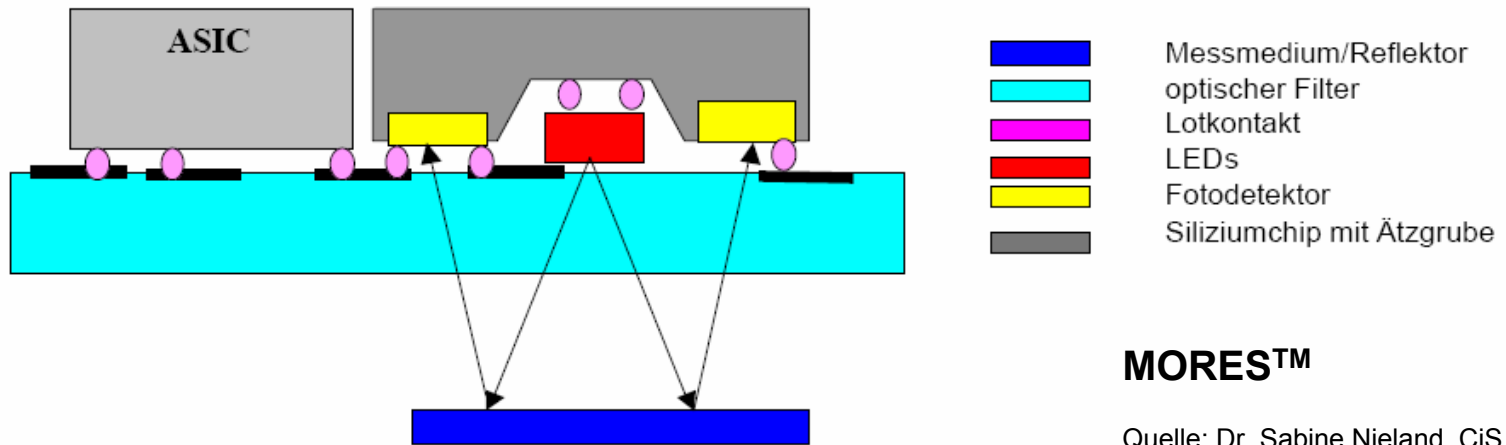


Überblick über die Praxismodule

Dietmar Naue

Geschäftsbereichsleiter Mikrotechnologie



→ **Strukturiierungsprozesse** –

Übertragung des Layouts mit **Fotolithografie**

①

→ **Assembly, Verbindung zur „Außenwelt“** –

Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT)

②

→ Weiterleitung der Signale (**Datenübertragung**) –

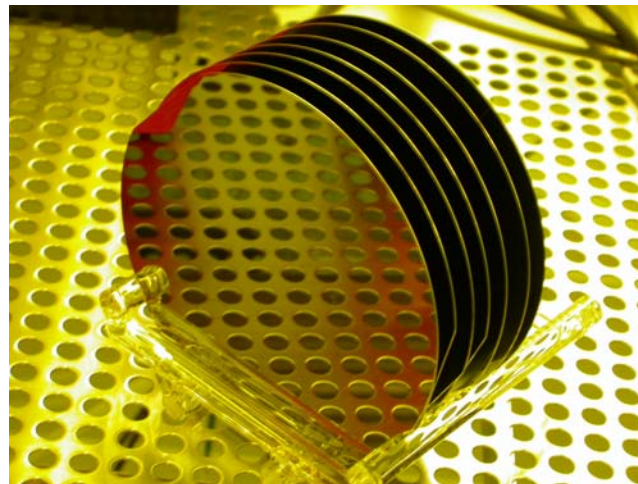
Beispiel: **Lichtwellenleitertechnik**

③

Herstellung von Bauelementen der Mikrosystemtechnik - Ein Kernprozess: Anwendung der Fotolithografie -

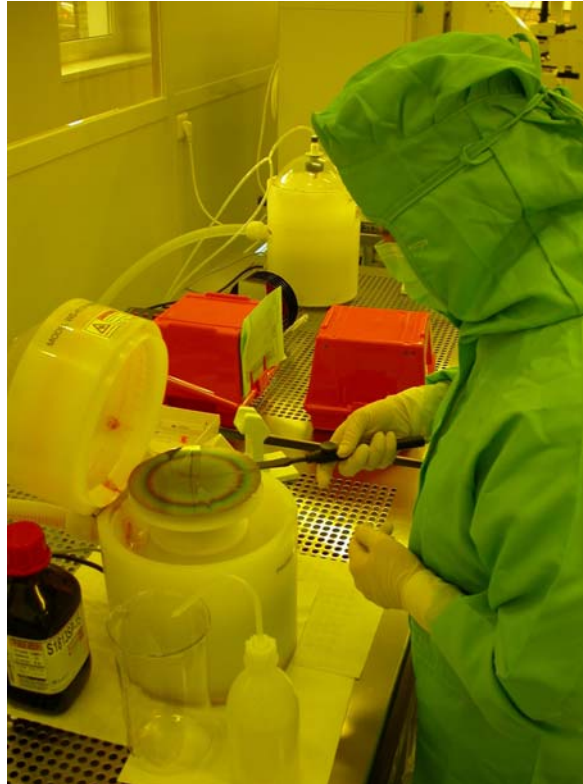
a)

Strukturierung von Schichten auf dem Wafer,
Erzeugung mikromechanischer Strukturen im Reinraum



Raum 3.2 → Cleanroom

Herr Seiffert
Herr Diezmann



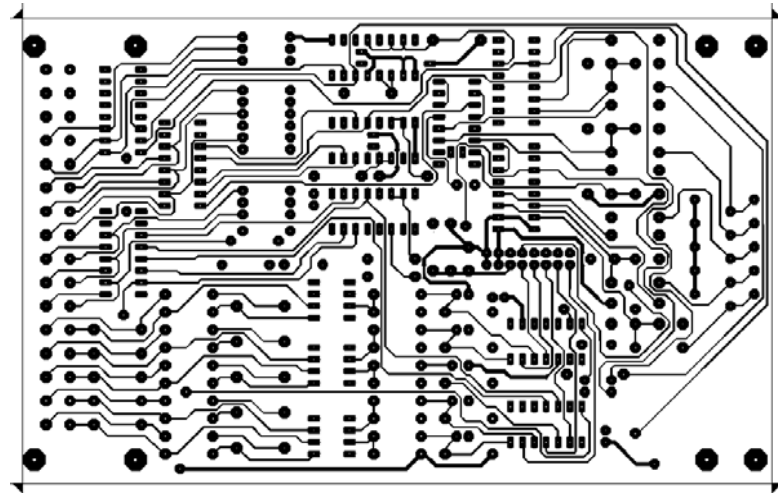
Partikel-
messung im
Reinraum



Herstellung von Bauelementen der Mikrosystemtechnik - Ein Kernprozess: Anwendung der Fotolithografie -

a)

Leiterplattenätzen –
Vom Layout zur fertigen Leiterplatte



Raum 3.2

→ Chemielabor

Herr Becker



Aufbau- und Verbindungstechnik in der Mikrosystemtechnik



Bestückung von Leiterplatten



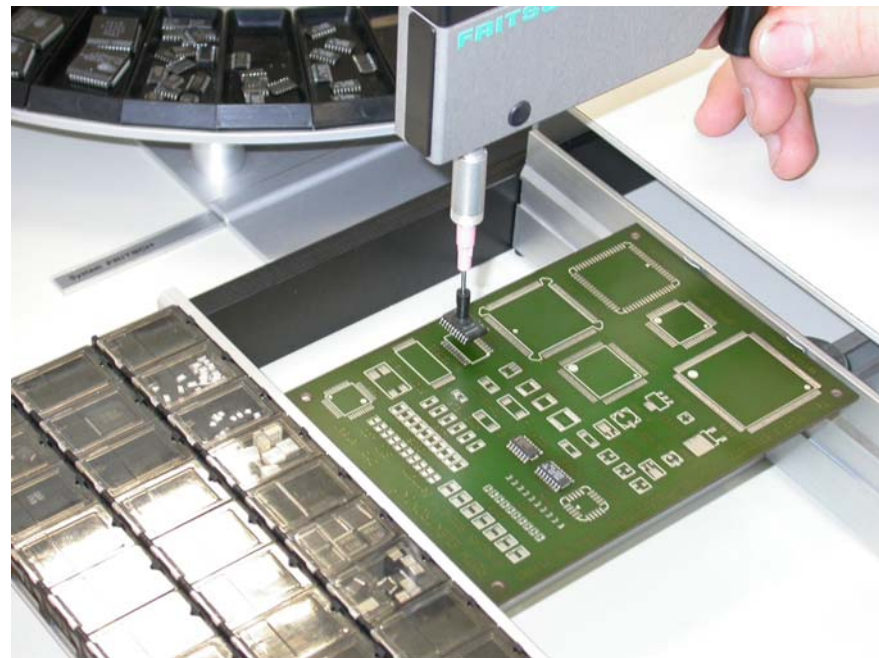
Kontaktierung von Bauteilen

Raum 3.4

→AVT-Bereich beim Cleanroom

Herr Wetter

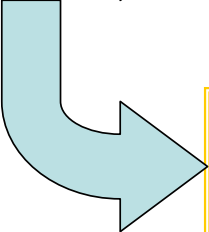
Herr Albrecht



Datenübertragung mittels Lichtwellenleiter



Herstellen einer Glasfaserverbindung



Vorstellung eines
Polymerfasersensormoduls

Raum 1.2 (IT-Labor)

Herr Bodo Poppe

Herr Udo Poppe

Frau Dr. Nieland

